

卷带芯片自动烧写机台

产品说明书

卢
氏
电
子

拆膜封膜型

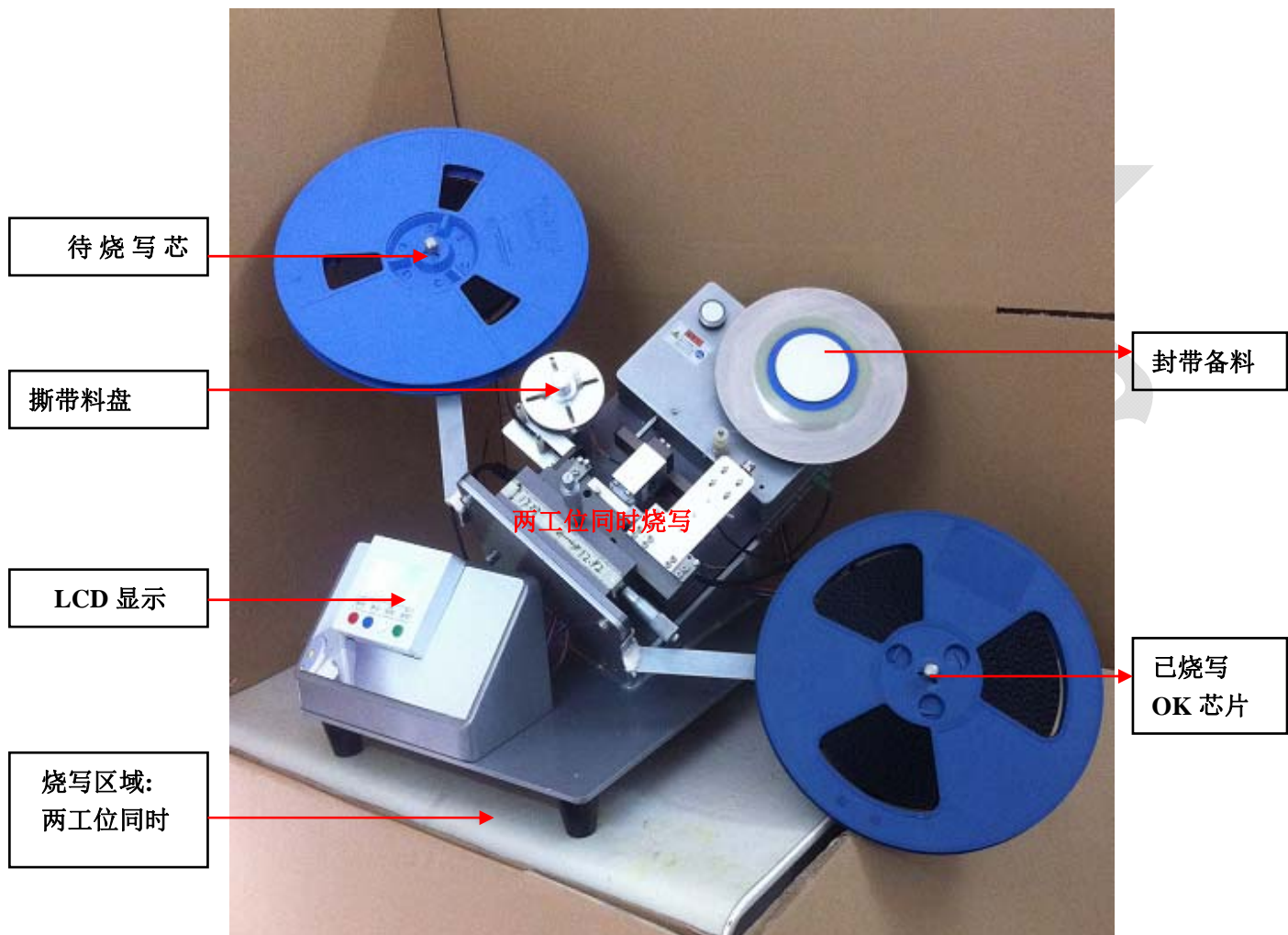
版次 V1.1

(详细请查看电子版)

制造商: 卢氏电子公司

- 电 话: 086-0755-84172042
- 手 机: 136-8249-7670(卢江 先生)
- 传 真: 086-0755-84172042
- 公司网址: WWW.SZLUS.COM
- 公司地址: 中国广东省 深圳市 龙岗区 布吉一村工业区第七栋 108 号

自动烧写·拆膜·封膜 编带烧写机



《不带支架实物图示》



《带支架实物图示》

目次

第一部分. 产品说明

1-1. 功能概述

1-2. 主要技术指标

第二部分. 烧写部分说明

2-1. 按键功能说明

2-2 菜单功能说明

2-3 简易操作流程

第三部分. 通讯以及维护

3-1. 通讯接口

3-2. 出现问题及处理方法

3-3. 维护及注意事项

第一部分. 产品说明

卷带 IC 自动烧录机是专门针对目前使用卷带包装形式芯片。提供自动拆膜+烧写+封膜一站式烧写。目前升级到两工位同时烧写。效率可以代替 3 个人工作量。最高速度 1600PCS/小时，通电即可工作。

1-1. 功能概述

机型: 自动编带烧写机(自动两工位同时烧写+拆带+封带一体机)

特性:

1. 两工位同时烧写。(注是单配头 2 倍)。
2. 全自动拆膜+烧写+封膜, 提供一站式服务。(解决同类产品中刺膜烧写易断, 易坏问题)
3. 工作环境电气控制, 不需要气体. 只要有电源即可。
4. 兼容性强, 更换简单的配件, 即可支持 SOP, SOT23 系列.
5. 全中文 LCD 显示. 操作简单.

功能: 用于芯片程式烧写或分测试, 起到替代人工, 大力节约成本。

适用: 卷带包装芯片

1-2. 主要技术指标

电源	220VAC±10% (需接地保护线)	
功率	200W 以下	
工作环境	温度: 0-40 度	湿度: 小于 90% (无结露)
裸机重量	15KG	
外型尺寸	外形尺寸 600mm*450mm*300mm	

第二部分. 烧写部分说明

2-1. 按键功能说明

主控制面板包括四个按键：“菜单”“确认”“▲”“▼”
“暂停”“烧写”

- “菜单”键**：进入或退出菜单选项。
在一级和二级菜单执行返回上一界面功能. 如果在烧写过程中想要进入菜单选择界面，先按“菜单”键等当前芯片烧写处理完后，显示屏会显示“用户密码”，此时必须输入密码再按“确认”键才能进入菜单选择界面。
- “确认”**：进入所选择的菜单目录和保存已设置的内容。
在菜单下执行菜单项目选择进入，或参数修正后保存退出。
- “▲” / “暂停”键**：暂停烧写或光标向上移动或数值增加。
在正常烧写模式、无烧录控模式以及调机自检模式下执行暂停功能，在菜单项目选择时作光标移动以及参数改变。
- “▼” / “烧录”键**：烧写开始或光标向下移动或数值减少。
在正常烧写模式、无烧录控模式以及调机自检模式下执行暂停功能，在菜单项目选择时作光标移动以及参数改变。

2-2. 卷带机菜单功能说明

一级菜单 二级菜单 三级菜单

1. 模式选择

- 1-1. 正常烧写模式 (表示正常烧写动作)
- 1-2. 无烧录 OK 模式 (表示 OK 演示模式)
- 1-3. 无烧录 NG 模式 (表示 NG 演示模式)
- 1-4. 恢复出厂参数 (表示恢复出厂参数)

2. 参数设置

2-1. 有效位设置

- 成功有效位: (设置 高/低 有效位)
- 失败有效位: (设置 高/低 有效位)
- 结束有效位: (设置 高/低/无 有效位)
- 开始有效位: (设置 高/低 有效位)

2-2. 压膜参数设置

- 压膜延时:
- 压膜孔数:

2-3. 撕膜参数设置

- 撕膜延时:
- 撕膜力度:
- 撕膜孔数:

2-4. 烧写条件设置

1. 芯片孔数
2. 超时报错
3. 微调距离
4. 不良处理 (自动取料/不良暂停/手动取料)
5. 按键时间: (按键所需反应时间)
6. 不良摆动数: (出现 NG 时重测的次数)
7. 摆动间隔: (NG 重测之间等待的时间)
8. 延时烧录
9. 工位选择
- 10 数量 (预设数量/总数查看)

3. 烧写器选择

- 1.标准烧写器
- 2.中颖烧写器 P3
- 3.松翰烧写器 旧
- 4.硕飞 SP8-F

- 5.义隆烧写器
- 6.建荣一拖一旧
- 7.义隆新烧写器
- 8.台湾河洛 ALL100

- 9.台湾凌阳 SunPluS
- 10.MicroChip-PM3
- 11.PICKIT3
- 12.上海山景集成

- 13.SPI FLASH(SN)
- 14.松翰烧写器新
- 15.士兰微烧写器
- 16.西尔特 501S

- 17.合泰 EW-PLUS
- 18.合泰 EW-PRO
- 19.合泰 EW-MSR
- 20.三星防串货

- 21.中颖烧写器 P6
- 22.建荣一拖四新
- 23.飞林烧写器
- 24.现代烧写器

.....

4.硬件自检

- 1. 进口处传感器: 阻挡/过孔
- 2. 上位感应: 未到/到位
- 3. 下位感应: 到位/未到
- 4. 无料指示灯: 开/关
- 5. 异常指示灯: 开/关
- 6. 报警音开关: 开/关
- 7. 探针下降: 下降/停止
- 8. 探针上升: 上升/停止
- 9. 进带电机释放: 释放/自锁
- 10. 进带调试: 动行/停止
- 11. 自动出料: 运行/停止
- 12. 自动退料: 运行/停止
- 13. 加热电磁铁: 开/关
- 14. 自动撕带
- 15. 前工位信号测
- 16. 后工位信号测
- 17. 单次烧写测试

- 1. 成功位 1:
- 2. 失败位 1:
- 3. 运行位 1:
- 4. 开始位 1:

- 1. 运行位 2:
- 2. 失败位 2:
- 3. 成功位 2:
- 4. 开始位 2:

2-3. 简易使用操作步骤

第一步: 准备。 安装好卷带+卷带膜+空料带盘

- 1-1. 装好并穿好卷带膜
- 1-2. 放置待烧的卷带
- 1-2. 编带按顺序安装(拆膜要装在拆膜机上,编带要放在齿轮上)

第二步: 烧写器连接好并上电(注意方向)

第三步:

- 3-1. 进入"硬件自检"进入"卷带调试,对好初始位置
 - 3-2. 通过探针下降与上升对好 IC 测试位
- (注:一般用户密码:101)

第四步: 正常烧写(设置工位数)

按烧写键即可自动烧写

第五步: 不良处理

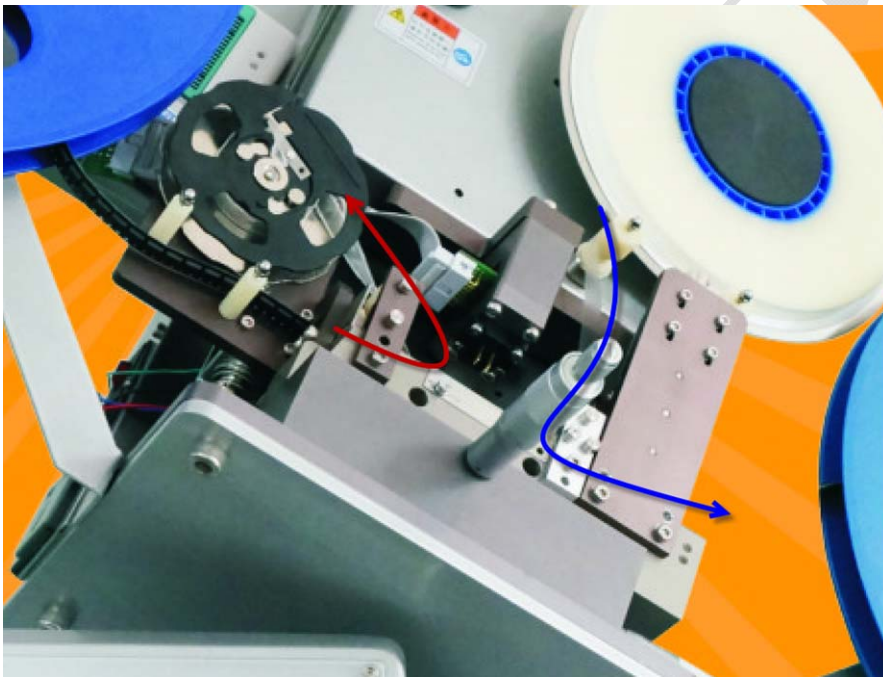
当移动一位后发现不良,出现如下提示

```
8 7 6 5 4 3 2 1
- - - 0 Y Y YN
```

处理方法:打开最后一位遮盖,取换新的 IC,再盖上,按烧写键继续

2-4. 使用说明

1. 打开机器开关，把加热头插上，开始加热，5 分钟后，把新的盖带，按照蓝线的方向穿过机器。把料盘放到进料盘位置，料带带膜的一面向上，带孔的一边在里面。穿过导料柱和光电传感器的的方槽，抬起压膜盖，撕开的膜从盖板的方孔穿过去，按照红线的方向绕到卷料盘上，孔位卡到卷带齿轮上，把盖子盖平。



2. 调整前后手柄和左右手柄的位置。让探针找到 IC 的正确位置。

机器出厂时已经调试好位置，请找工程人员要位置数值，直接旋动手柄到相应位置，即可开始烧录。如果换用不同厂商的编带，可能位置需要微调。请参考调试的指导说明。每次把数值记录下来，下次可以直接调用数值。

3-1. 通讯接口

RS232-DB9 引脚	信号线说明
1	BUSY: 测试结束信号, 高电平为保证 5mA 的灌电流
2	FAIL: NG 信号, 高电平为保证 5mA 的灌电流
3	OK: OK 信号, 高电平为保证 5mA 的灌电流
4	KEY: 测试请求信号(开漏输出)驱动电流不小于 5mA
5	GND: 信号地
9	VCC: 5V 电压信号

3-2. 出现问题及处理方法

1. 进料口出现卡料

原因: 料带走完或马达不转或未压位或传感器坏

- 对策:
1. 检查料带。
 2. 检查传感器。
 3. 检查进带马达。

2. 不良率多

原因: 探针损坏或未对准

- 对策:
1. 检查探针
 2. 检查上下是否对准

注意: 如果出现了上述问题之外的问题, 请及时与本公司的工程师联系, 切勿擅自操作!

3-3. 维护注意事项

1. 当给料出现卡料需要处理时一定要先”暂停”再处理,防止芯片打坏
2. 张贴好对应的工位号以及接通读口的位置,不能接错
3. 机台的存入区域应避免有太多沉屑,以免沾上太多的污物,影响机台工作时的性能,特别是导轨以及电路板,传感器部分,做到定期用软刷子清洁
4. 不能用金属尖锐工具碰及导轨表面,如果出现卡料,只能用牙签类物品去处理
5. 机台不使用时尽可能采用专用的防尘布进行严密的遮盖,不用时一定要关电,盖上防尘布
6. 测试探针是损耗品,如果沾上污物,请用脱胎换骨脂棉和无水酒精进行清洗并自然晾干,必要时可以先用细砂纸进行打磨。如果长时间使用后出,形变必须更换新探针

A.如何阅读手柄的读数

微调手柄左边固定刻度上排是毫米为单位,下排是每个刻度的中分点,也就是 0.5 毫米的位置指示。右边活动刻度是 50 等分,转动一圈是 0.5 毫米,也就是每个刻度是 0.01 毫米。在读取数值的时候首先看左边固定刻度,然后加上右边的活动数值。以下面两个为例,第一个数值是 10.30MM,第二个数值是 10.80MM.



B.如何知道 IC 的位置扎准了没有

1.进入手动菜单点卷带步进,找到要烧录的 IC,点单次烧录。完成后退到主菜单,以 TSSOP8 为例讲述位置调整方式。

2.调整位置

TSSOP8 烧录的左右位置可以用肉眼来对准。前后的位置需要一点技巧。先调整一个靠前或者靠后的位置。

然后手柄 5 格 5 格的调整。一般在烧录 OK 位置大概有 20 到 30 个格是可以的,取这个区域的中间值即可。

C.在烧录过程中,第一次不良高,总是第二次烧录好,那么证明 IC 偏左,需要逆时针调整一点左右手柄。总是第三次烧录好,需要顺时针调整一点左右手柄。